

Briselē, 2018. gada 21. novembrī
(OR. en)

14559/18
ADD 1

ENV 797
MI 870
DELECT 153

PAVADVĒSTULE

Sūtītājs:	Direktors <i>Jordi AYET PUIGARNAU</i> kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra vārdā
Saņemšanas datums:	2018. gada 19. novembris
Saņēmējs:	Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretārs <i>Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN</i> kungs
K-jas dok. Nr.:	C(2018) 7499 final - Annex
Temats:	PIELIKUMS dokumentam - Komisijas Deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu par svinu lodmetālos, ko izmanto stabila elektrisko savienojumu izveidei starp pusvadītāja kristālu un nesēju apvērsto integrālskāmu (flip-chip) pakotnēs

Pielikumā ir pievienots dokuments C(2018) 7499 *final - Annex*.

Pielikumā: C(2018) 7499 *final - Annex*

Briselē, 16.11.2018.
C(2018) 7499 final

ANNEX

PIELIKUMS

dokumentam

Komisijas Deleģētā direktīva,

ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu par svīnu lodmetālos, ko izmanto stabila elektrisko savienojumu izveidei starp pusvadītāja kristālu un nesēju apvērsto integrālshēmu (flip-chip) pakotnēs

PIELIKUMS

Direktīvas III pielikumā 15. ierakstu aizstāj ar šādu:

“15	Svins lodmetālos stabilu elektrisko savienojumu izveidei starp pusvadītāja kristālu un nesēju apvērsto integrālshēmu (<i>flip-chip</i>) pakotnēs	Attiecas uz 8., 9. un 11. kategoriju un zaudē spēku: – 2021. gada 21. jūlijā attiecībā uz 8. un 9. kategoriju, izņemot attiecībā uz <i>in vitro</i> diagnostikas medicīniskajām ierīcēm un rūpnieciskajiem monitoringa un kontroles instrumentiem; – 2023. gada 21. jūlijā attiecībā uz 8. kategorijas <i>in vitro</i> diagnostikas medicīniskajām ierīcēm; – 2024. gada 21. jūlijā attiecībā uz 9. kategorijas rūpnieciskajiem monitoringa un kontroles instrumentiem un attiecībā uz 11. kategoriju.
15(a)	Svins lodmetālos stabilu elektrisko savienojumu izveidei starp pusvadītāja kristālu un nesēju apvērsto integrālshēmu (<i>flip-chip</i>) pakotnēs, ja ir izpildīts vismaz viens no šādiem kritērijiem: – pusvadītāju tehnoloģiskā norma ir vismaz 90 nm; – viena kristāla izmērs pie jebkuras pusvadītāju tehnoloģiskās normas ir vismaz 300 mm²; – grēdoto kristālu pakotnēs kristāla izmērs ir vismaz 300 mm² vai silikona interpozeru izmērs ir vismaz 300 mm².	Attiecas uz 1.–7. un 10. kategoriju un zaudē spēku 2021. gada 21. jūlijā.”